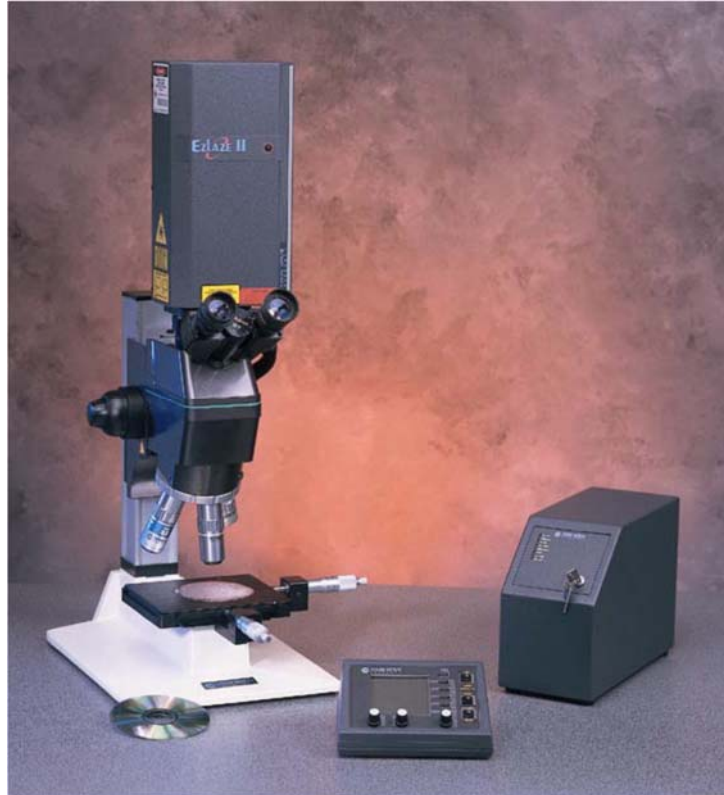


# 激光切割機

## (New Wave EzLaze II)



### 功能/應用

用於半導體故障分析。

### 產品規格

- 樣品台：可容納 8 英寸晶圓
- 顯微鏡物鏡：
  - 2X and 10X M Plan Apo（用於明場觀察物鏡）
  - 50X M Plan Apo NIR（近紅外輻射範圍物鏡）
  - 100X M Plan NUV（近紫外輻射範圍物鏡）
- 均勻地從 50 $\mu$ m x 50 $\mu$ m（使用 50 倍物鏡）切割到 1  $\mu$ m x 1 $\mu$ m（使用 100X 物鏡）
- 用戶可選的波長（1064nm，532nm，355nm 和/或 255nm）切割和加工各種材料
- CCD：能夠進行視頻捕獲

## 應用

- 最常見的應用包括：
  - 切割跡線以修復、隔離或停用電路的某個部分。
  - 去除頂層以暴露金屬、氧化物、氮化物或其他材料下方的跡線，以實現電路的微探測
- 其他應用程序包括：
  - 使用電子束系統進行探測時，去除頂面以提高分辨率
  - 在小體積或工程模式下修整電阻
  - 在設備內標記區域，以顯示聚焦離子束切割的位置。

## Recommended Wavelengths for Cutting Materials

IR (1064nm)	Green (532nm)	UV3 (355nm)	UV4 (266nm)
Aluminum	Copper	Polyimide	Polyimide
	Gold	Kapton	Kapton
	Poly Silicon	Silicon	Silicon
	Aluminum	Nitride	Nitride
		SOG	SOG
		Silicon Oxide	Silicon Oxide

LCD	Infrared (1064 nm)	Green (532 nm)	Ultraviolet (355 nm)
<b>Materials:</b>	ITO Chromium Color Filter-red, green	ITO Chromium Color Filter-blue/green	Color Filter-blue/green
<b>Semiconductor Materials:</b>	Aluminum Gold Ti-Tungsten	Silicon Dioxide Nitride Polyimide (big cuts) SOG , Poly-silicon Gold	Nitride Polyimide Gold Aluminum Ti-Tungsten

設備製造商網頁

[http://www.ece.ucy.ac.cy/labs/holistic\\_elab/facilities/brochures/EZlazeII.pdf](http://www.ece.ucy.ac.cy/labs/holistic_elab/facilities/brochures/EZlazeII.pdf)